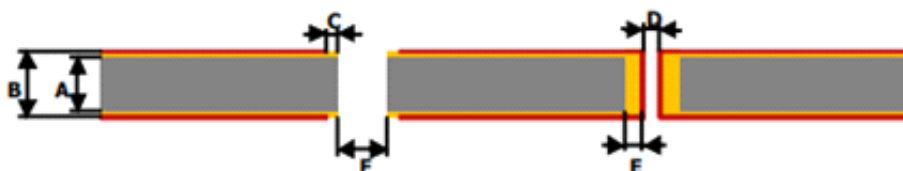


Datenblatt Herstellung Leiterplatten, IMS Aluminium, durchkontaktiert

Basismaterialien	Materialstärke	1,0 / 1,5 / 2,0 mm
	min. Kupfer-Dicke	35 µm
	max. Kupfer-Dicke	105 µm
	T _g	130 °C
	Wärmeleitfähigkeit	1,0 / 1,5 / 2,2 W/ mK
Layout	Strukturbreite	125 µm
	Strukturabstand	125 µm
	uml. Löstoplack-Freistellung	50 µm
	kleinster Löstoplack-Steg	150 µm
	kleinster Fräsradius	1000 µm
Oberfläche	kleinster Ritzwinkel	30 °
	HAL bleifrei	
	HAL SnPb	
	chem. Zinn	
	chem. Ni/Au	
Lötstopplack	chem. Ag	
	grün / schwarz / blau / rot ...	
	superweiß (für LED- Anwendungen)	
	abziehbare Lötdeckmaske	
	Kaptonband, hitzebeständig bis 260°C	
Kennzeichendruck	weiß / gelb / schwarz ...	
Qualitätskontrolle	optische Kontrolle	
	AOI	
	elektrischer Test	
	Erstmusterprüfung	
Daten	vorzugsweise Gerberdaten	
	Eagle	
	TARGET, PROTEL, Altium, etc.	
Zertifikate / Normen	ISO 9001:2015	
	IPC-A-600	
andere Ausführungen auf Anfrage		

Design-Rules Alu-Kern



A	Dicke Alu-Kern	1,0; 1,5; 2,0 mm
B	Dicke LP	Alu-Kern + ca. 0,2 mm
C	Abstand Kupfer zu NDK-Bohrungen	mind. 0,2 mm
D	kleinste Bohrung durchkontaktiert	0,3 mm
E	Freistellung um DK-Bohrungen	0,3 mm
F	kleinste NDK-Bohrung	mind. Dicke des Alu-Kern